

# Bergquist贝格斯Gap Pad HC1000导热材料GPHC1000导热硅胶片

产品名称	Bergquist贝格斯Gap Pad HC1000导热材料GPHC1000导热硅胶片
公司名称	广州锐旭科技有限公司
价格	160.00/张
规格参数	品牌:贝格斯 型号:GapPadHC1000 产地:美国
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X130 1-E2433(仅限办公用途)(JM)
联系电话	020-36966020 18927581781

## 产品详情

贝格斯Gap Pad HC1000导热片凝胶状模量的间隙填充导热材料颜色：灰色特点：高服贴，低硬度，凝胶状模量，玻璃纤维基材，抗穿刺，抗剪切和抗撕裂导热系数：1.0W/m-K说明：Gap Pad HC1000是一种极其服贴、低模量的高分子聚合物，用在电子元器件和散热器之间作为导热绝缘界面材料，该凝胶状模量的材料可以轻易填充空气间隙，从而增强电子系统的导热性能，供货时附带了双面保护离型膜。典型应用：计算机和外设,通讯设备,需要将热量传递到机架、机箱或其它散热装置的场合,RDRAMTM存储模块,在不平整表面和散热器之间作为导热界面,DDR SDRAM存储模块,全缓冲内存(FBDIMM)模块规格：2款厚度(0.38mm,0.51mm)片材：(203mm\*406mm)